

2023年11月

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

序章.....	2
一、11月宏观经济.....	2
1、全球制造业保持低速，市场波动下行.....	2
2、电子信息制造业复苏稳定，分化明显.....	3
3、半导体销售和产量持续上升，前景乐观.....	4
二、11月芯片交期趋势.....	6
1、整体芯片交期趋势.....	6
2、重点芯片供应商交期一览.....	6
三、11月订单及库存情况.....	19
四、11月半导体供应链.....	20
1、半导体上游厂商.....	21
(1) 硅晶圆/设备.....	21
(2) 原厂.....	22
(3) 晶圆代工.....	24
(4) 封装测试.....	25
2、分销商.....	26
3、系统集成.....	27
4、终端应用.....	28
(1) 消费电子.....	28
(2) 新能源汽车.....	29
(3) 工控.....	30
(4) 光伏.....	31
(5) 储能.....	32
(6) 服务器.....	32
(7) 通信.....	33
五、分销与采购机遇及风险.....	34
1、机遇.....	34
2、风险.....	34
六、小结.....	36
免责声明.....	37

图表目录

图表 1: 11 月全球主要经济体制造业 PMI.....	3
图表 2: 2023 年最新电子信息制造业运行情况.....	3
图表 3: 2023 年最新全球半导体行业销售额及增速.....	4
图表 4: 2023 年最新全球及中国集成电路产量及增速.....	4
图表 5: 2023 年最新中国集成电路进出口金额及增速.....	5
图表 6: 11 月费城及申万半导体指数走势.....	5
图表 7: 11 月芯片交期趋势.....	6
图表 8: 2023 年 11 月主要厂商交期及趋势一览.....	6
图表 9: 11 月头部企业订单及库存情况.....	19
图表 10: 11 月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况.....	22
图表 11: 11 月主要原厂最新动态.....	23
图表 12: 11 月主要晶圆代工厂最新动态.....	24
图表 13: 11 月主要封测厂商动态情况.....	25
图表 14: 11 月主要元器件分销商最新动态.....	26
图表 15: 11 月主要系统集成商最新动态.....	27
图表 16: 11 月消费电子厂商最新动态.....	28
图表 17: 11 月新能源汽车厂商最新动态.....	29
图表 18: 11 月工控厂商最新动态.....	30
图表 19: 11 月光伏厂商最新动态.....	31
图表 20: 11 月储能厂商最新动态.....	32
图表 21: 11 月服务器厂商最新动态.....	32
图表 22: 11 月通信厂商最新动态.....	33
图表 23: 11 月细分市场机会关注.....	34
图表 24: 11 月细分市场风险预警.....	34

序章

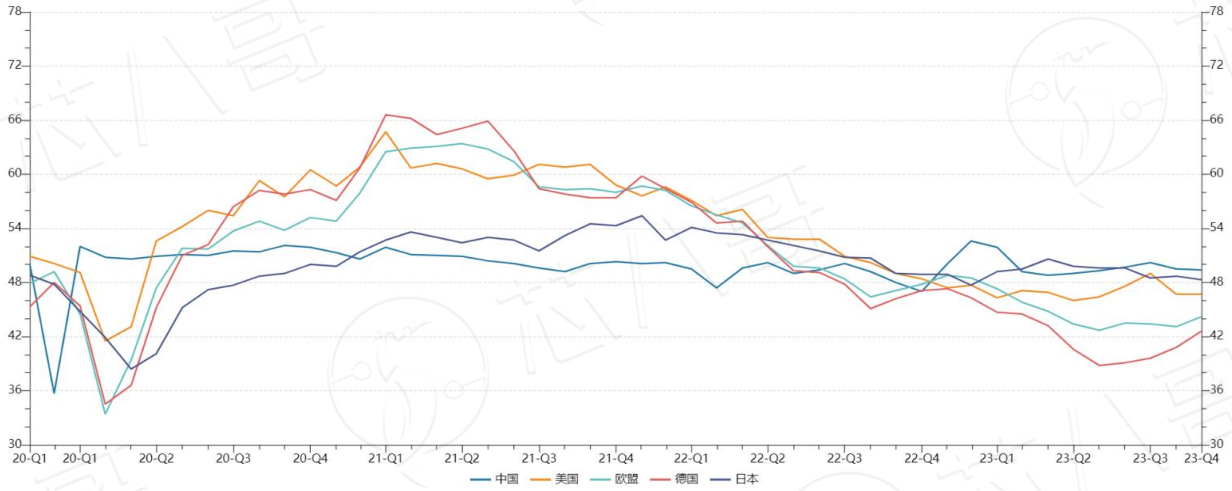


一、11月宏观经济

1、全球制造业保持低速，市场波动下行

11月，全球经济不稳定特征显现，包括中国、美国、欧盟、日本等主要经济体呈现波动下行态势。

图表 1: 11 月全球主要经济体制造业 PMI



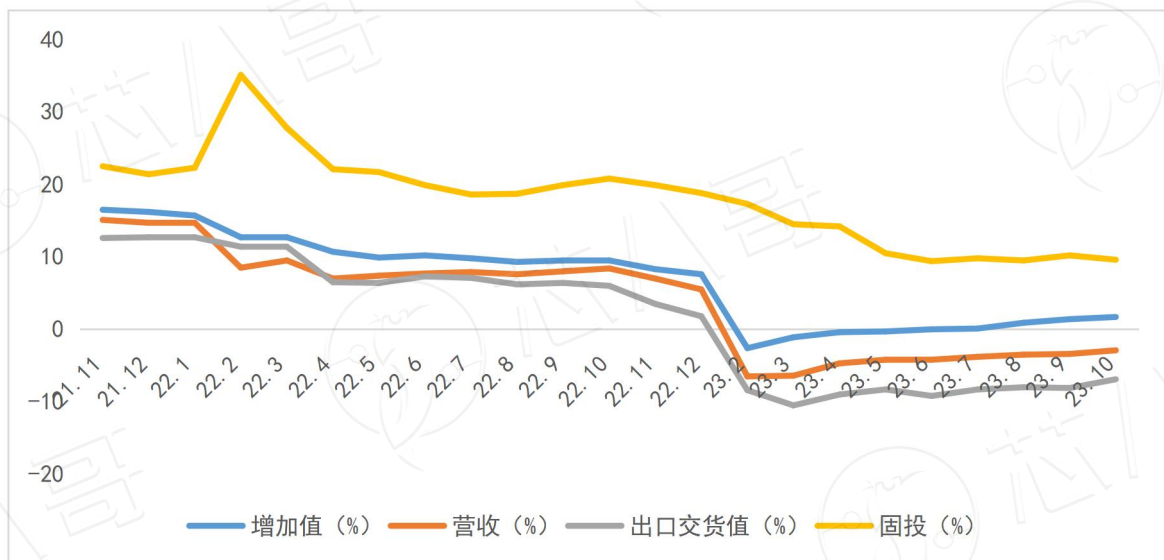
资料来源: 国家统计局

IMF 预测今明两年世界经济增长将持续放缓, 其中 2023 年经济增速预计为 3.0%, 2024 年约 2.9%。

2、电子信息制造业复苏稳定, 分化明显

2023 年 1-10 月, 中国电子信息制造业生产持续回升, 出口降幅收窄, 效益持续改善, 投资稳定增长, 地区营收分化明显。

图表 2: 2023 年最新电子信息制造业运行情况

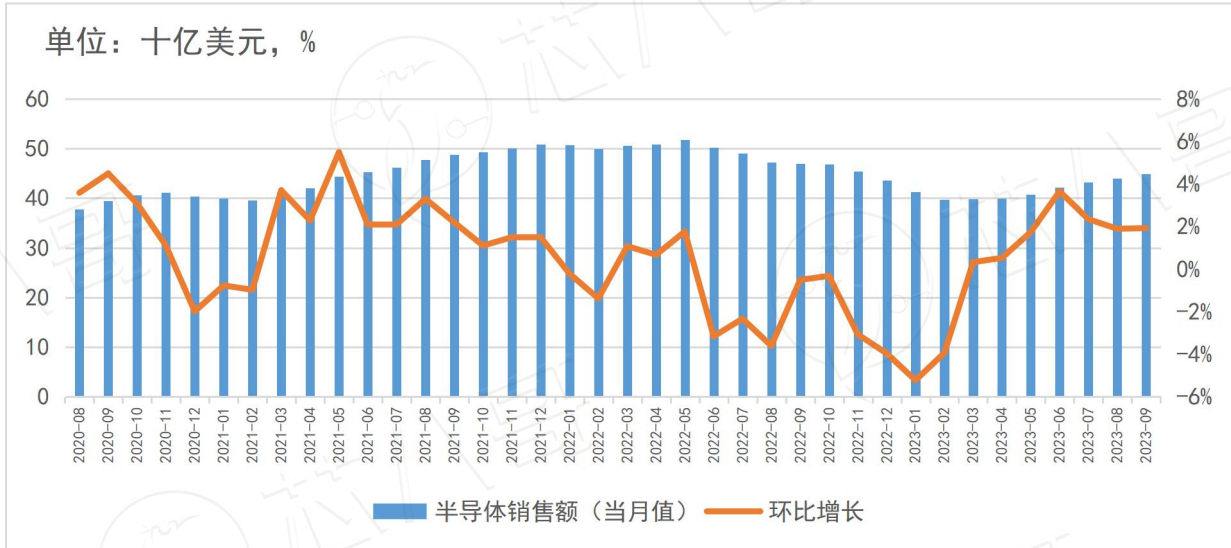


资料来源: 工信部

3、半导体销售和产量持续上升，前景乐观

根据 SIA 最新数据，9 月全球半导体销售额达 448.9 亿美元，环比增长 1.9%，行业需求前景看好。

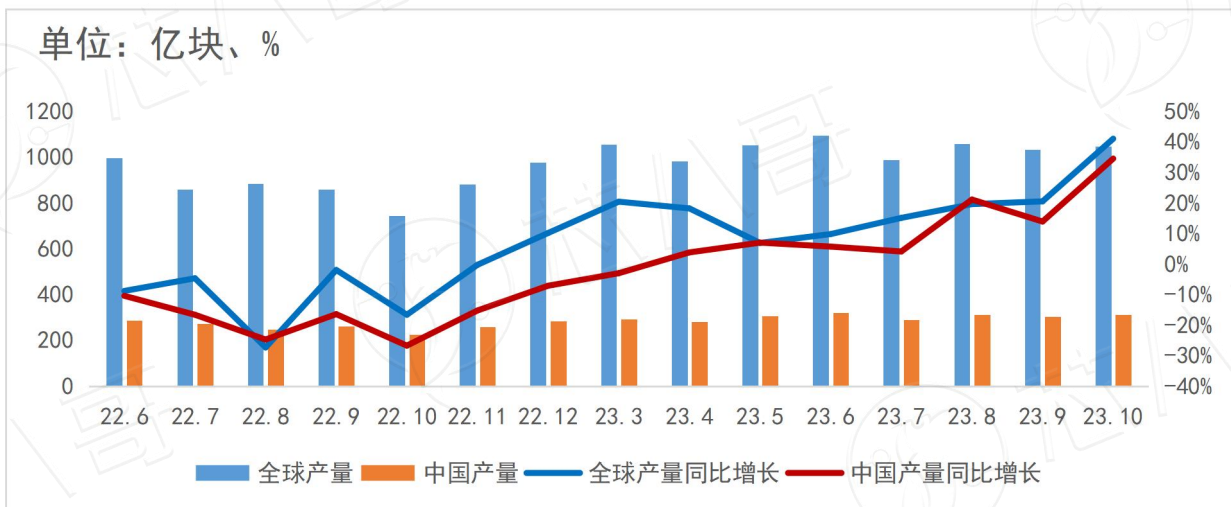
图表 3：2023 年最新全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看，10 月全球集成电路产量约 1048 亿块，同比增长 41%；中国产量达 313 亿块，同比增长 34.5%，回升趋势明显。

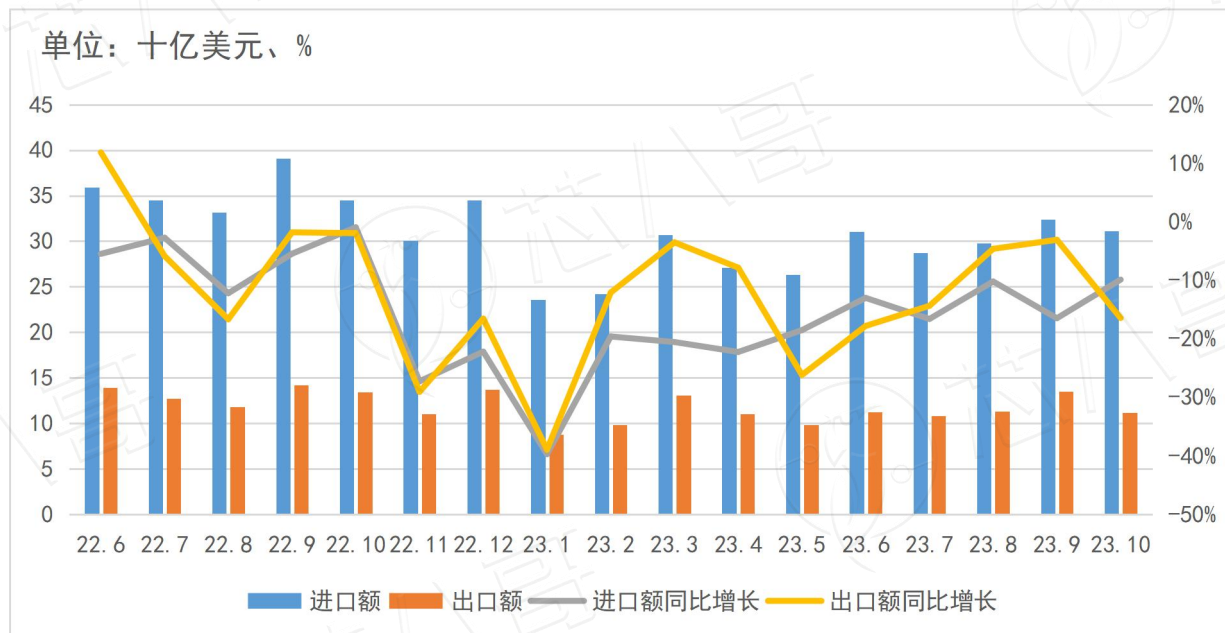
图表 4：2023 年最新全球及中国集成电路产量及增速



资料来源：工信部、SIA、芯八哥整理

进出口方面，10月中国集成电路进出口金额有所下跌，有一定波动。

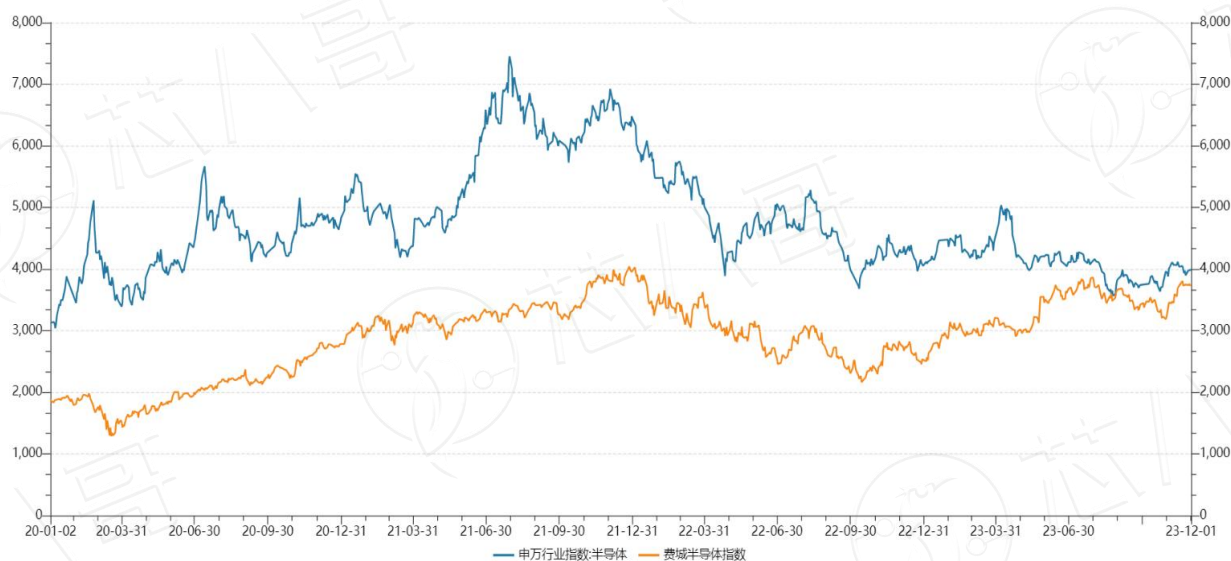
图表 5：2023 年最新中国集成电路进出口金额及增速



资料来源：工信部、SIA、芯八哥整理

从资本市场指数来看，11月费城半导体指数(SOX)上涨13.18%，中国半导体(SW)行业指数上涨0.76%，市场信心有所下跌。

图表 6：11月费城及申万半导体指数走势



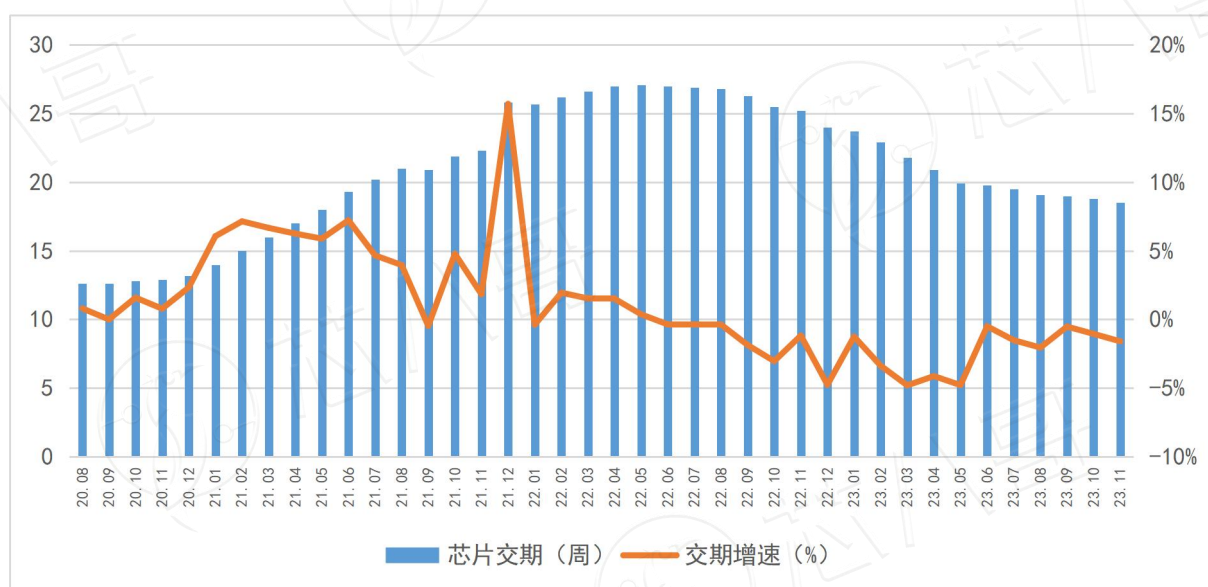
资料来源：Wind

二、11月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

11月，全球芯片交期持续向好，增速有所趋缓，承接力有支撑，预示库存去化趋近尾声。

图表 7：11月芯片交期趋势



资料来源：SFG、芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

从11月各供应商看，交期持续缩短，但仍处较高水平。部分存储型号价格开始回升，消费/工业等MCU价格进入筑底阶段，国产MCU厂商停止价格战。

图表 8：2023年11月主要厂商交期及趋势一览

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	16-24	16-24	稳定	根据市场调

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
						整
	BOSCH	传感器	12-20	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/ 电源	30-40	30-40	稳定	稳定
		开关稳压 器	25-45	25-45	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	26-40	26-40	缩短	稳定
	Infineon	传感器	18-52	18-52	稳定	上升
		开关稳压 器	40-52	40-52	稳定	稳定
		汽车模拟 和电源	45-52	45-52	稳定	稳定
	ADI (Maxim)	放大器和 数据转换 器	20-30	20-30	稳定	上升
		接口	20-30	20-30	稳定	上升

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
		开关稳压 器	20-35	20-30	延长	稳定
	Microchip	放大器 和数据转换 器	30-40	30-40	稳定	稳定
		定时	30-40	30-40	稳定	稳定
		开关稳压 器	40-50	30-40	稳定	上升
	MPS	开关稳压 器	45-50	45-50	缩短	稳定
	NXP	传感器	16-52	16-52	延长	上升
		接口	26-30	26-30	缩短	稳定
		汽车模拟 和电源	45-52	45-52	稳定	稳定
	On Semi	传感器	18-52	18-50	稳定	根据市场调 整

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
		放大器和数据转换器	26-42	26-42	稳定	稳定
		定时	35-42	35-42	稳定	稳定
		多源模拟/电源	35-42	35-42	稳定	稳定
		开关稳压器	35-50	30-40	稳定	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
		放大器和数据转换器	36-40	36-40	稳定	稳定
	Renesas	定时	50	50	稳定	稳定
		接口	36-40	30-40	稳定	稳定
		开关稳压器	36-40	30-40	缩短	上升

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压 器	50	50	稳定	稳定
		传感器	12-18	12-18	缩短	稳定
		放大器和 数据转换 器	20-36	20-36	缩短	稳定
	ST	多源模拟/ 电源	40-50	40-50	稳定	稳定
		开关稳压 器	40-50	40-50	稳定	稳定
		汽车模拟 和电源	40-52	40-52	稳定	稳定
	TE	传感器	16-52	16-52	延长	上升
	Vishay	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
射频	Infineon	蓝牙模块	26-36	26-36	缩短	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
和无 线	Microchip	WiFi 模块	24-26	16-26	缩短	稳定
		蓝牙模块	24-26	12-26	稳定	稳定
		收发器/接收器	18-20	18-20	稳定	上升
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Laird	WiFi 模块	26-52	26-52	稳定	稳定
		天线	16-20	16-20	延长	稳定
	ST	蓝牙模块	12-16	12-16	稳定	稳定
		收发器/接收器	52	52	延长	上升
		RFID	30-40	30-40	稳定	稳定
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	20-40	20-40	稳定	上升
大功率 IC		52	52	延长	上升	

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
	On Semi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定
分立 器件	Diodes	低压 MOSFET	18-52	18-52	缩短	根据市场调 整
		TVS 二极 管	18-24	8-14	缩短	稳定
		桥式整流 器	12-40	8-30	稳定	稳定
		肖特基二 极管	14-35	14-35	缩短	稳定
		整流器	14-40	8-30	稳定	稳定
		开关二极 管	12-52	12-52	稳定	稳定
		小信号 MOSFET	30-45	20-30	稳定	稳定
		齐纳二极 管	14-35	14-35	缩短	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
		双极晶体 管	14-45	14-30	缩短	稳定
		数字晶体 管/RETS	14-35	14-35	缩短	稳定
		通用晶体 管	14-35	14-35	缩短	稳定
		逻辑器件	20-22	8-10	稳定	稳定
	Infineon	低压 MOSFET	18-48	18-48	缩短	稳定
		高压 MOSFET	39-56	39-56	缩短	稳定
		IGBT	39-50	39-50	稳定	稳定
		宽带隙 MOSFET	42-52	42-52	稳定	稳定
		数字晶体 管/RETS	12-52	12-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
	ST	通用晶体 管	12-52	12-52	稳定	稳定
		军用-航空 晶体管	22-45	22-45	稳定	上升
		低压 MOSFET	50-54	50-54	稳定	稳定
		高压 MOSFET	47-52	39-52	缩短	稳定
		IGBT	47-52	47-52	稳定	稳定
		ESD	30-45	30-45	稳定	稳定
		宽带隙 MOSFET	42-52	42-52	稳定	稳定
		晶闸管 /Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极 管	30-40	30-40	稳定	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
		整流器	44-46	14-30	稳定	稳定
		双极晶体 管	40-52	40-52	稳定	稳定
	Wingtech (Nexperia)	低压 MOSFET	40-52	16-52	缩短	稳定
		ESD	12-40	6-18	稳定	稳定
		肖特基二 极管	4-20	4-20	缩短	稳定
		开关二极 管	8-50	8-50	缩短	稳定
		小信号 MOSFET	10-26	10-26	缩短	稳定
		齐纳二极 管	4-20	4-20	缩短	稳定
		双极晶体 管	4-20	4-20	缩短	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
		数字晶体 管/RETS	4-20	4-20	缩短	稳定
		通用晶体 管	4-20	4-20	缩短	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
MCU	Renesas	8位 MCU	18-24	18-24	缩短	稳定
		32位 MCU	18-24	18	缩短	稳定
		汽车	45	45	稳定	稳定
		32位 MPU	18-26	18-26	稳定	稳定
	ST	8位 MCU	35-52	35-52	缩短	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32位 MPU	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32FO	16-20	10-12	缩短	稳定
		STM32F1	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32L	16-20	16-20	缩短	稳定
		32位 MCU	35-48	20-28	缩短	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
	Infineon	8位 MCU	26-52	26-52	稳定	稳定
		32位 MCU	26-52	10-52	缩短	稳定
		汽车	32-45	紧缺	稳定	稳定
	Microchip	8位 MCU	36-52+	26-52+	缩短	稳定
		32位 MCU	36-52+	26-52+	缩短	稳定
		32位 MPU	30-52	30-52	稳定	稳定
	NXP	8位 MCU	26-52	26-52	缩短	稳定
		32位 MCU	13-52	13-52	缩短	稳定
		汽车	35-52	35-52	稳定	稳定
		32位 MPU	18-52	18-52	缩短	稳定
可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	20-65	20-65	稳定	上升
	Intel (Altera)		30-55	30-55	稳定	上升
	Lattice		30-50	30-50	稳定	稳定
	Microchip (Microsemi)		32-42	32-42	缩短	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
存储器	Samsung	DRAM (商用 PC)	52-54	52-54	稳定	稳定
		存储器模块	52-54	52-54	稳定	根据市场调整
		eMMC	52-54	52-54	稳定	稳定
		固态硬盘(SSD)	52-54	52-54	稳定	稳定
	SK Hynix	NAND flash	6-10	6-10	缩短	根据市场调整
		eMMC	8-12	8-12	稳定	根据市场调整
		滤波器	12-16	12-16	缩短	稳定
被动元件	Murata	电感/变压器	12-20	12-20	稳定	稳定
		引线陶瓷电容	16-18	16-18	稳定	稳定

类别	供应商	产品	11月交期/周	12月交期/周	交期趋势	价格趋势
		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
		滤波器	40-55	40-55	延长	上升
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	稳定
	TDK	表面贴装 通用陶瓷 电容(车规 级)	30-42	30-42	稳定	稳定

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、11月订单及库存情况

从企业订单看，汽车需求维持增长，工业需求疲软，消费/IOT持续改善。整体库存持续改善，但仍处于较高水平。

图表 9：11月头部企业订单及库存情况

公司	11月订单情况	11月库存情况	12月定价趋势
Intel	下降	一般	稳定
AMD	下降	一般	稳定
三星	下降	一般	上升

公司	11月订单情况	11月库存情况	12月定价趋势
TI	下降	较高	根据市场调整
ST	稳定	低	根据市场调整
ADI	稳定	低	稳定
Qualcomm	下降	一般	下降
Broadcom	下降	一般	根据市场调整
NXP	稳定	低	上升
Infineon	上升	低	上升
Renesas	稳定	低	根据市场调整
Onsemi	稳定	无	稳定
Microchip	稳定	一般	稳定
Micron	下降	一般	上升
SK Hynix	下降	一般	上升
Murata	下降	低	稳定
联发科	下降	一般	根据市场调整

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、11月半导体供应链

设备/材料需求稳定，代工产能下跌，原厂订单波动，终端持续回暖。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

11月，原料订单持续疲软，设备需求逐渐改善。

图表 10: 11月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	11月订单	11月库存	12月订单预测
设备	ASML	上升	低	上升
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	下降	低	稳定
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco(胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	上升

资料来源：芯八哥整理

(2) 原厂

11月，芯片需求复苏明显，消费类需求可见度较高。

图表 11: 11月主要原厂最新动态

厂商	11月动态
Intel	硅光模块业务出售捷普
AMD	新 AI 芯片明年营收将达 20 亿美元
英伟达	或推出中国区最新改良版 AI 芯片；Q4 中国市场销售额或下滑
TI	犹他州第二座 12 寸晶圆厂动工，或 2026 年投产
Qualcomm	最新财报手机业务同比下滑 30.2%
三星	将持续调涨 NAND Flash 价格；明年 Q1 CIS 涨价 25%-30%
联发科	手机库存逐步恢复至相对健康的水位
Broadcom	AI 相关订单需求增加；完成收购后裁掉多名 VMware 员工
ADI	工业半导体需求全面下降
ST	11 月 32 位 MCU 价格持平
Infineon	2024H2 消费电子/通信/物联网有望复苏；车用半导体需求旺盛
NXP	Q3 移动业务收入环比增长 33%
Qorvo	智能手机客户需求大幅提升
Onsemi	预计 Q4 业绩放缓裁员 900 人
KIOXIA	存储价格已触底反弹，明年出货量增加

厂商	11月动态
WD	与铠侠合并未果，宣布将分拆闪存业务
SK Hynix	2030年公司HBM出货量将达1亿颗/年
Micron	2024年存储供需关系将大幅改善；HBM量产进度面临困境
Marvell	中国台湾SSD团队或裁员
威刚	存储报价至少涨到2024年上半年
安世	英国NWF晶圆厂被Vishay 1.77亿美元收购
兆易创新	Q4 MCU价格仍趋于平稳并筑底
北京君正	消费市场芯片价格度过调降阶段
盛群	MCU单价趋稳，2024年或谷底回升
顺络电子	下半年手机呈现出结构性复苏态势

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

11月，成熟制程持续降价拉升产能，先进制程需求稳定。

图表 12：11月主要晶圆代工厂最新动态

厂商	11月产能利用率	11月动态	12月价格趋势
台积电	85%	2024年针对成熟制程降幅约2%；今年底3nm 月产6~7万片	稳定

厂商	11月产能利用率	11月动态	12月价格趋势
三星	80%	8英寸代工降幅或高达10%；计划扩建其美国德州芯片工厂	下降
联电	60%	明年Q1成熟制程降价，最高达两位数百分比	下降
中芯国际	77%	下半年半导体市场仍在底部	下降
格芯	85%	目前开工率不足，预计Q4利润好于预期	稳定
世界先进	65%	预计Q4晶圆出货季减8-10%	下降
力积电	60%	拟投资26亿美元与日本SBI共建芯片工厂	下降
华虹	86.8%	Q4产能利用率或将环比回升	下降

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

11月，行业头部厂商利润回升，订单逐渐回升，先进封装需求量价齐升。

图表 13：11月主要封测厂商动态情况

厂商	11月产能利用率	11月动态	12月订单预测
日月光	65%	AI订单暴涨	上升
长电科技	80%	Q4毛利率稳健，明年需求将回暖	稳定

厂商	11月产能利用率	11月动态	12月订单预测
通富微电	85%	先进封装产能提升，盈利能力逐步改善	稳定
华天科技	85%	封装产品价格相对稳定	下降
气派科技	75%	二期厂房主要投入先进封装等产品生产	下降
中小封测厂	60%	订单有回升，但产能利用率相对较低	下降

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

11月，元器件分销整体行情回升，存储需求改善明显。

图表 14：11月主要元器件分销商最新动态

厂商	11月动态
Avnet	Q3 库存环比有所上升
文晔科技	Q3 库存改善明显
中电港	Q3 增加了存储类及处理器 MCU 等业务备货
香农芯创	存储需求行情回升
商络电子	被动件账期约 3~4 个月；小米、禾赛是公司客户
雅创电子	业务主要聚焦于汽车电子领域
好上好	库存水平相对较低

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

11月，工控需求疲软，新能源汽车需求增长，消费类需求修复。

图表 15：11月主要系统集成商最新动态

类别	厂商	11月动态
工控	ABB	聚焦中国生物制药研发及医疗领域商机
	霍尼韦尔	工业相关产品库存有所上升
	施耐德电气	光储直柔示范基地落户武汉
	罗克韦尔	年初以来库存上升趋势明显
	汇川技术	公司在积极布局力传感器产品
汽车	电装	丰田计划减持公司 10%股权
	大陆	汽车业务持续亏损，拟裁员数千人
	博世	氢动力系统重庆新工厂投入使用
	舍弗勒	拟将 Vitesco 收购价提升至 38 亿欧元
	安波福	Q3 高压、ADAS 业务增长强劲
	采埃孚	内燃机收入比重从 60%降到 27%
	博格华纳	苏州工厂新能源电控产量达 200 万台
消费电子	闻泰科技	2023 年预计将为荣耀研发制造 800 多万部手机

类别	厂商	11月动态
	华勤技术	消费电子数字终端业务稳中向好
	立讯精密	公司是华为与奇瑞合作汽车的高压/高速/低压连接器供应商
	歌尔股份	消费电子相关业绩稳步修复
	鸿海	子公司将斥资 1282 亿卢比在印新建工厂
	广达	GPU 供应短缺将延续到 2024H1

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

11月，智能手机及PC复苏高于预期，供应链需求回升。

图表 16：11月消费电子厂商最新动态

类别	企业	11月动态
智能手机	苹果	Q4 iPhone 15 需求仍强，中国尤其明显
	三星	计划明年智能手机产量增加 10%
	华为	华为 P70 出货将暴增 230%；Mate 60 Pro 本土零件价值超 70%
	OPPO	与微软达成 Phone Link 战略合作
	小米	Q3 智能手机出货量环比增长 27%
	荣耀	折叠智能手机全年累计产量已经突破 100 万台

类别	企业	11月动态
PC	联想	PC 市场已经触底，反弹在即
	宏碁	渠道库存回归健康的 6~8 周
	华硕	明年笔电需求相对乐观
	戴尔	预计 2024 年 PC 可能小幅增长
VR/AR	Meta	头显销售不及预期
	苹果	Vision Pro 头显或明年 3 月发售
	PICO	将裁上千名员工

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

11 月，新能源汽车需求持续增长，东南亚市场成厂商布局重点。

图表 17：11 月新能源汽车厂商最新动态

厂商	11月动态
比亚迪	或成为全球电动车单季出货量第一
特斯拉	或在印度设厂；泰国或投资超 50 亿美元
本田	将增加在泰国电动汽车产量
大众	拟 3 年内在华推出本土电动汽车平台
宝马	计划推出 2025 年新电动 SUV

厂商	11月动态
奔驰	与宝马合作建设超级充电网络
丰田	一汽丰田或因库存压力减产；向美国混动和电动汽车电池工厂增资 80 亿美元
福特	电动汽车部门亏损扩大
广汽埃安	11月销量超 4 万辆，或将成为最快突破百万产销品牌
吉利	旗下沃尔沃推出能源解决方案新业务部门
奇瑞	2024 年将推超 10 款新能源车
蔚来	将裁员 10%
理想	2024 年销量预测为 80 万辆
长城	全面进入欧洲
小米	汽车进展超预期
华为	剥离车 BU 业务，长安入股

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

11月，工控行业需求尚未明显回升，进口 PLC 价格部分涨价。

图表 18：11月工控厂商最新动态

厂商	11月动态
西门子	S7-300 等 PLC 系列产品最高涨幅达 53%

厂商	11月动态
安川电机	拟在美投资 2 亿美元生产工业机器人
汇川技术	围绕与主业高度协同的自动化及上下游产业链等方向开展投资并购
英威腾	未来工业自动化行业需求将保持稳定增速
禾川科技	Q3 伺服市场同比下滑 3.9%
埃斯顿	海外业务订单发展较好
新时达	Q3 库存有所回调，但整体较高

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

11 月，光伏行业量增价跌，内部竞争激烈，库存去化持续。

图表 19：11 月光伏厂商最新动态

厂商	11月动态
阳光电源	行业内部竞争激烈，同质化愈发严重
天合光能	行业存在量增价跌隐忧
锦浪科技	欧洲户用光储逆变器库存水平较高
固德威	行业库存去化持续改善中
英威腾	光伏储能业务 2023 年前三季度营收 2.74 亿元，同比增长 68.19%
德业股份	行业库存水平较高

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

11月，储能产能扩张出现明显放缓迹象，高速增长或不可持续。

图表 20：11月储能厂商最新动态

厂商	11月动态
阳光电源	目前储能产业“内卷”现象严重；Q3 欧洲户储预计渠道库存去化完毕
科士达	储能业务以欧洲市场为主
上能电气	国内大储行业需求前景看好
科陆电子	美国储能市场需求不及预期；计划在珠三角地区投建生产基地
德业股份	储能出货承压，Q4 将逐步修复
天合光能	公司明年储能有望在今年的基础上实现翻番
宁德时代	储能行业产能严重过剩
固德威	Q4 公司储能渠道库存有望去化完毕
特斯拉	将在中国开启储能超级工厂建设

资料来源：芯八哥整理

(6) 服务器

11月，传统服务器库存去化结束，AI 服务器需求快速增长。

图表 21：11月服务器厂商最新动态

企业	11月动态
英伟达	下一代 AI 加速 GPU B100 或明年 Q2 发布
AMD	新 AI 芯片明年营收将达 20 亿美元
戴尔	AI 服务器零部件大幅扩产约 200%
联想	2024 年投资主线聚焦 AI 服务器市场
广达	明年 AI 服务器持续增长
工业富联	在美国、德国持续扩产 AI 服务器；通用服务器库存去化结束

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

11 月，行业订单需求低迷，库存仍处较高水平。

图表 22：11 月通信厂商最新动态

企业	11月动态
思科	因订单放缓，下调年度营收及利润预期
中兴通讯	通信相关产品库存处于较高水平
爱立信	预计全球 5G 用户总数在 2023 年将达到 16 亿
诺基亚	前三季度营收下滑 5.22%，库存有所上升

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

11月，关注存储产业链复苏机会，看好汽车及AI市场需求增长。

图表 23：11月细分市场机会关注

产品	市场机会	相关企业
汽车 CIS	2022-2030 年全球汽车 CIS 年复合增速达 13%	onsemi、豪威、索尼及三星等
存储芯片	美光预计 2024 年存储行业复苏，2025 年创纪录	三星、SK Hynix 及 Micron 等
GPU	高需求使 GPU 预定时间延长至 52 周	英伟达、AMD 及华为等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

11月，MLCC、工业 MCU 需求疲软，关注光伏产业链风险。

图表 24：11月细分市场风险预警

产品	风险预警	相关企业
MLCC	2023 年全球 MLCC 市场增长 3%，进入低速成长期	村田、TDK 及国巨及等
MCU	工业 MCU 等芯片需求全面下降	TI、ST 及 ADI 等
逆变器	近期多个光伏组件招标价逼近 1 元关口	阳光电源、锦浪科技及固德威等

资料来源：芯八哥整理

六、小结

综上，根据芯八哥研判，全球半导体月度销售额持续回升，Q2 以来半导体厂商整体营收环比改善，库存去化接近尾声。半导体行业由库存周期转向需求周期趋势明显，叠加近期智能手机新品对于市场复苏拉动，行业景气周期加速回调，重点关注国产智能手机供应链发展。

时至岁末，进入到本轮周期底部供需博弈的振荡阶段，行业在曲折中酝酿向上动能。在此阶段，半导体业者更需分辨各终端领域其中蕴含的风险及潜在机遇，谨慎应对行情反复，注意手头现金流状况，同时密切关注国际地缘政治、经济贸易及汇率变化，适时调整供应链市场策略。

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2023年12月

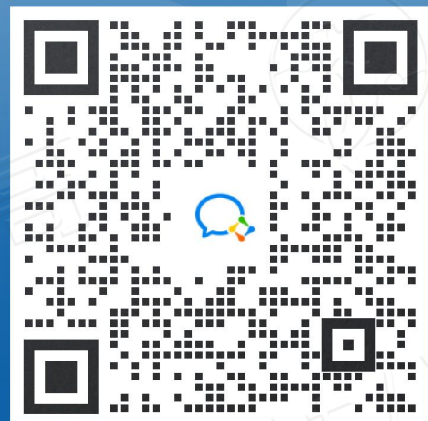


<<< 扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、
厂商动态和行业趋势报告

加入芯八哥半导体行业交流群 >>>

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、
行业白皮书免费领取





更高效 更透明 重构产业生态

仓储服务 元器件采购 信息服务 API/FTP
PCB制板 BOM工具 SAAS

www.hqengroup.com

深圳总部

电话：86-755-83396000

传真：86-755-26421633

地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦
B座4、7、12楼